

深圳佰维存储科技股份有限公司

投资者关系活动记录汇总表

(2024年8月28日)

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><input type="checkbox"/>特定对象调研 <input type="checkbox"/>媒体采访 <input type="checkbox"/>新闻发布会 <input type="checkbox"/>专场机构交流会 <input type="checkbox"/>其他 _____</p>	<p><input type="checkbox"/>分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/>业绩说明会 <input type="checkbox"/>路演活动 <input type="checkbox"/>现场参观</p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>参与公司 2024 年半年度业绩说明会的投资者</p>	
<p>会议时间</p>	<p>2024 年 8 月 28 日 15: 30-16: 30</p>	
<p>会议地点</p>	<p>价值在线 (www.ir-online.cn)</p>	
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事长 孙成思 总经理 何瀚 董事会秘书兼财务总监 黄炎烽 战略部总监 肖博天</p>	
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>2024 年 8 月 28 日，公司在价值在线平台召开了 2024 年半年度业绩说明会，公司管理层对 2024 年上半年业绩情况进行了总结与分析，并与参会的投资者进行了互动交流，交流内容如下：</p> <p>Q1. 从晶圆端和产品端看，当前存储价格呈现怎样的变化趋势？ A1: 2024 年二季度存储价格上涨，晶圆端与产品端保持同向变动；三季度价格继续保持同向变动，整体平稳，略有波动。</p> <p>Q2. 从终端来看，如何展望下半年手机、PC、服务器的需求？ A2: 展望下半年，手机市场需求方面，预计 2024 年下半年与上半年相比保持平稳，需要持续关注各大手机厂商推出的 AI 手机新品是否能够拉动市场；PC 市场需求方面，OEM 厂商的需求复苏有所放缓，随着 AIPC 新品上市，预计高性能内存产品将有所增长；服务器市场需求方面，全球服务器市场呈现出地域性差异，下半年国内市场需求平稳，而北美市场则较为旺盛，AI 成为推动服务器市场需求增长的关键要素。</p> <p>Q3. 公司毛利率在上半年提升幅度较大，是否会保持逐季增长？长期来看，驱动公司营收和利润增长的主要因素有哪些？ A3: 公司毛利率变动主要受产品结构、上游原材料供应情况、存储市场需求波动、市场竞争格局变化等因素综合影响。随着库存结构的更新，公司毛利率会逐渐回归到中枢水平。从长期来看，公司持续加强研发投入、新产品的开发和技术能力的提升有助于进一步助推公司营收和利润的增长，全球化的布局和自有品牌建设也将助力提升公司长期的营收和盈利水平。</p>	

Q4. 公司目前有哪些产品可以用于车规市场？未来车规存储放量进度如何预期？

A4：公司已经推出了车规级 eMMC、LPDDR、NOR Flash 等产品，满足车规客户的不同需求与场景，并通过严苛的 AEC-Q100 车规可靠性验证。公司产品正在导入国内头部车企及 Tier1 客户。未来，公司将不断扩展车规存储品类，提升市占率，力争成为主要参与者。

Q5. 目前模组厂纷纷布局封测产能，公司自成立之初就构建了封测能力，有哪些先发优势？

A5：公司在成立之初就建立了自有封测厂，是行业内率先布局研发封测一体化的企业，拥有深厚的积累，目前已掌握 16 层叠 Die、30~40 μ m 超薄 Die、多芯片异构集成等先进工艺量产能力，达到国际一流水平。公司在先进封测领域拥有领先的能力，具备先发优势。同时，公司在原有封测基础上，正在布局晶圆级先进封测能力，符合存储芯片和逻辑芯片的整合趋势，公司技术实力和产业价值有望进一步提升。

Q6. 公司的晶圆级先进封测制造项目进展如何？团队的背景是怎样的？预计什么时候能为客户提供服务？

A6：公司顺应先进存储器发展需要以及存储和逻辑整合技术的趋势，于 2023 年 11 月正式落地东莞松山湖晶圆级先进封测制造项目，该项目实施主体为公司控股子公司广东芯成汉奇。公司已经构建了完整的、国际化的专业晶圆级先进封装技术团队，团队成员均具备在国际知名半导体企业的工作经历，具有成熟研发和量产经验。该项目尚处于前期投入阶段，正在建设中，预计将于 2025 年投产，为客户提供整套的先进封装测试解决方案。

Q7. 公司研发费用率及管理费用率都环比提升的主要原因是什么？公司研发费用重点投入的方向是哪些？

A7：公司 2024 年上半年研发费用率提升，主要原因为公司持续加大芯片设计、解决方案研发、先进封测及存储测试设备等领域的研发投入力度，并大力引进行业优秀人才；另外，本期新增研发人员股份支付费用。公司 2024 年上半年管理费用率提升，主要原因为公司业务规模及员工人数持续增加，且本期新增管理人员股份支付费用，导致管理费用增加。在研发投入方向方面，公司将持续研发具有行业竞争力的消费级、工车规和企业级存储产品，并持续投入自研主控芯片设计、先进封测工艺研发、高速测试设备开发等产业链关键环节。

Q8. 各大终端厂商都在发力 AI，公司在 AI 相关的业务有什么布局？

A8：公司与 OPPO、传音等主要的 AI 手机厂商和 HP、联想、Acer 等主要的 AIPC 厂商建立了密切的合作关系，新产品在不断导入。公司面向 AI 手机已推出 UFS3.1、LPDDR5/5X、uMCP 等嵌入式存储产品；面向 AIPC 已推出 DDR5、PCIe4.0 等高性能存储产品；面向服务器，已推出企业级 SATA SSD、企业级 PCIe SSD、RDIMM 和 CXL 内存等产品。公司始终保持敏锐洞察力，面对 AI

	<p>端侧设备本地化部署和轻量化模型的发展趋势，积极探索存储创新应用，赋能新兴终端应用的规模化落地。</p> <p>Q9. 公司当前库存情况如何，未来准备采取怎样的备货策略？ A9：2024 年上半年，公司存货为 35.74 亿元，与 2024 年一季度基本持平。2024 年以来，公司采取较为中性的备货策略，按需采购，预计将继续保持按需采购的备货策略。</p> <p>Q10. 公司接下来的存储产业规划如何？对于各业务市场地位有什么预期？ A10：公司将进一步强化研发封测一体化布局，在存储解决方案研发、主控芯片设计、存储器封测/晶圆级先进封测和存储测试机等产业链关键环节不断突破，服务产业发展新趋势，贡献更大价值。同时，公司将持续坚持“5+2+X”的发展战略，在手机、PC、服务器等三大主要细分市场着力提升市场份额与核心竞争力，力争实现与更多一线客户的深度合作；在智能穿戴和工车规市场投入战略性资源，力争成为主要参与者；持续布局芯片设计和晶圆级先进封测，打造公司二次增长曲线；对存算一体、新接口、新介质和先进测试设备等创新领域进行探索与开拓。通过以上战略布局，兼顾公司短/中/长期发展目标，推动公司持续构建新质生产力，提升公司的价值和股东回报。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 8 月 28 日
备注	接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息披露等情况。